

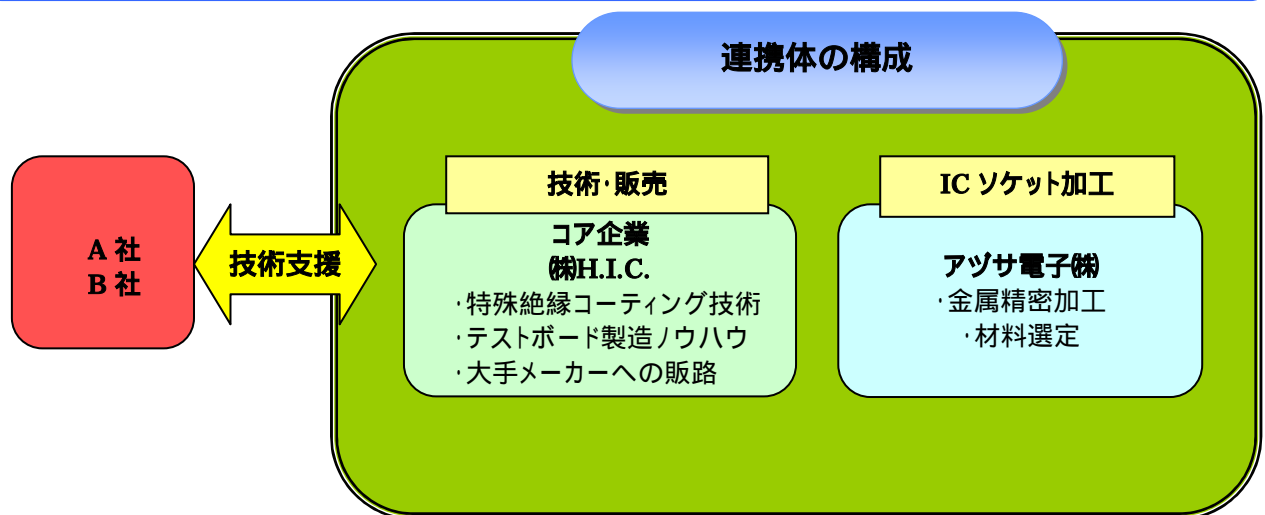
地域	関東(東京都)	事業分野	製造業(機械)	認定日	平成18年7月21日
----	---------	------	---------	-----	------------

テーマ名:高信頼性アルミ IC ソケットの開発と事業化

事業計画の概要:

- ・ IC 信頼性試験の最終工程に電気特性が正常であることを検査測定する工程が存在する。実装基板においては半田付けを行うために接触不良は起こらないが、この最終工程においては、半田付けをせず IC ソケットに挿入するだけで検査測定を行うため、接触不良が発生しやすい。
- ・ さらに IC の情報量増大に伴う大型化により、樹脂性のソケット強度では接触面の歪みが発生しやすく、接触不良率が増大。結果正常な IC の不良判定が増加し、IC 歩留まりの悪化につながっている。
- ・ 本件は従来の樹脂性の IC ソケットを、絶縁処理を施したアルミ製の IC ソケットに変えることで、ソケット強度強化を実現。接触不良を減少させ、IC の歩留まりを飛躍的に向上させるもの。
- ・ このアルミ製 IC ソケットをコア企業の有する絶縁コーティング技術、テストボード製造ノウハウおよび連携企業の材料選定ノウハウ、アルミ高精度加工技術を持ち寄り実現。大手 IC メーカーとの協力により事業化する。

コア企業: ㈱H.I.C.(東京都昭島市:その他の電子部品製造業)
 連携中小企業: アツサ電子㈱(東京都八王子市)



連携の特徴

コア企業の開発したコーティング技術、テストボード製造ノウハウをベースに、アルミ精密加工、材料選定ノウハウを有する企業との連携により新商品を実現。

新事業

アルミに絶縁コーティングを施したソケットは存在せず(特許出願中)

市場性

IC メーカーの現場ニーズを捉えた商品の提供であり、すでにメーカーの協力を得ながら進めてきた事業で極めて市場性が高い。

支援予定メニュー

事業化・市場化補助金